



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22647XAR

Issue Date:21 Apr 2020

Title of Change:	EMC change from Samsung SI7200DX2 to KCC KTMC1050GFB for TO-220 package in SHEDCL.	
Proposed First Ship date:	15 Aug 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Khairil.FK@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Lalan.Ortega@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified by date code	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor wishes to inform our customers of a change in mold compounds used for the devices listed in this PCN. This is the final product change notification (FPCN) of IPCN22647. This change is a result of an End of Life notification received from Samsung for several of their SDI Mold Compounds. Due to the discontinuance of the SDI mold compounds, ON Semiconductor will only have limited supplies of the existing material and in some cases this may not allow for the normal change notification period. All other aspects of the impacted products (form, fit, function) will remain unchanged.		
	Before Change Description	After Change Description
Mold Compound	SI7200DX2; Supplier: Samsung SDI	KTMC1050GFB, Supplier : KCC



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: KSC5338D (PTI : FD)RMS : U59923, O62949PACKAGE : TO220 3L AL SNGL PBF STD

Test	Specification	Condition	Interval	Results
EV	JEDS22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/77
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, 80% rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
uHAST	JESD22-A118	Ta = 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
H3TRB	JEDS22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/15
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	JESD22-A104, Appendix 6 J-STD-035		0 hr	0/25
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/2
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/2
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HAST	1008 hrs	0/2

QV DEVICE NAME: FYP2010DNTU (PTI : FB)RMS : J65321, U61116, O61732PACKAGE : TO220 3L AL COMP PBF JMD

Test	Specification	Condition	Interval	Results
EV	JEDS22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/231
HTRB	JESD22-A108	Ta = 145°C, 80% rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JEDS22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	JESD22-A104, Appendix 6 J-STD-035		0 hr	0/75
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HAST	1008 hrs	0/6

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [**PCN Customized Portal**](#).

Part Number	Qualification Vehicle
KSC5338DTU	KSC5338D
KSC5603DTU	KSC5338D
FJP13009TU	KSC5338D
BUT11A	KSC5338D
KSC5021RTU	KSC5338D
KSC5027OTU	KSC5338D
FJP5027RTU	KSC5338D
FJP5027OTU	KSC5338D
KSC2334Y	KSC5338D
KSC2334YTU	KSC5338D
KSA1010YTU	KSC5338D
KSC5502DTTU	KSC5338D
FJP5555TU	KSC5338D
BDW93C	KSC5338D
KSC5338D	KSC5338D
KSD363YTU	KSC5338D
BDW93CTU	KSC5338D
FJP5304DTU	KSC5338D
KSE44H11	KSC5338D
KSE45H11	KSC5338D
FJP3305H1TU	KSC5338D
FJP3305H2TU	KSC5338D
BD244A	KSC5338D
KSB596YTU	KSC5338D
BD244CTU	KSC5338D
KSD526Y	KSC5338D



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22647XAR

Issue Date:21 Apr 2020

KSD526YTU	KSC5338D
KSD880O	KSC5338D
BD239CTU	KSC5338D
KSC2073H2TU	KSC5338D
KSC2073TU	KSC5338D
BD239C	KSC5338D
FYP2010DNTU	FYP2010DNTU
FYP2006DNTU	FYP2010DNTU
MBRP3010NTU	FYP2010DNTU
MBRP1545NTU	FYP2010DNTU
KSD560YTU	KSC5338D
BDW94C	KSC5338D
KSD363RTU	KSC5338D
KSB546YTU	KSC5338D
KSD880YTU	KSC5338D
KSA940TU	KSC5338D
FYP1010DNTU	FYP2010DNTU
MBRP3045NTU	FYP2010DNTU

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22647XAR

発行日: 21 Apr 2020

変更件名:	SHEDCL の TO-220 パッケージの EMC が Samsung SI7200DX2 から KCC KTMC1050GFB に変更されました。	
初回出荷予定日:	15 Aug 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Khairil.FK@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Lalan.Ortega@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます	
変更カテゴリ: アセンブリの変更		
変更サブカテゴリ: 材料の変更		
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
無し	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
説明および目的: オンセミコンダクターは、この PCN に記載されている製品に使用されているモールドコンパウンドの変更をお客様にお知らせします。 これは、IPC22647の最終製品変更通知 (FPCN) です。 この変更は、SDIモールドコンパウンドのいくつかについてSamsungから受けた生産終了の通知によるものです。 SDIモールド コンパウンドの廃止によって、オン・セミコンダクターでは既存の材料の供給が限定されるようになるため、場合によっては、このことによって通常の変更通知期間が不可能になる場合があります。 対象となる製品の他の特徴(形状、適合性、機能)には変更はありません		
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	SI7200DX2; Supplier: Samsung SDI	KTMC1050GFB, Supplier : KCC



信頼性データの要約:

デバイス名: KSC5338D (PTI : FD)RMS : U59923, O62949パッケージ: TO220 3L AL SNGL PBF STD

テスト	仕様	条件	間隔	結果
EV	JEDS22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/77
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, 80% rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
uHAST	JESD22-A118	Ta = 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
H3TRB	JEDS22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/15
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	JESD22-A104, Appendix 6 J-STD-035		0 hr	0/25
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/2
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/2
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HAST	1008 hrs	0/2

デバイス名: FYP2010DNTU (PTI : FB)RMS : J65321, U61116, O61732パッケージ: TO220 3L AL COMP PBF JMD

テスト	仕様	条件	間隔	結果
EV	JEDS22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/231
HTRB	JESD22-A108	Ta = 145°C, 80% rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JEDS22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	JESD22-A104, Appendix 6 J-STD-035		0 hr	0/75
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HAST	1008 hrs	0/6

**電気的特性の要約:**

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
KSC5338DTU	KSC5338D
KSC5603DTU	KSC5338D
FJP13009TU	KSC5338D
BUT11A	KSC5338D
KSC5021RTU	KSC5338D
KSC5027OTU	KSC5338D
FJP5027RTU	KSC5338D
FJP5027OTU	KSC5338D
KSC2334Y	KSC5338D
KSC2334YTU	KSC5338D
KSA1010YTU	KSC5338D
KSC5502DTTU	KSC5338D
FJP5555TU	KSC5338D
BDW93C	KSC5338D
KSC5338D	KSC5338D
BDW94C	KSC5338D
KSD363YTU	KSC5338D
BDW93CTU	KSC5338D
KSD363RTU	KSC5338D
FJP5304DTU	KSC5338D
KSE44H11	KSC5338D
KSE45H11	KSC5338D
FJP3305H1TU	KSC5338D
FJP3305H2TU	KSC5338D
KSD560YTU	KSC5338D
BD244A	KSC5338D
KSB546YTU	KSC5338D
KSB596YTU	KSC5338D
BD244CTU	KSC5338D



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN22647XAR

発行日 : 21 Apr 2020

KSD526Y	KSC5338D
KSD526YTU	KSC5338D
KSD880O	KSC5338D
KSD880YTU	KSC5338D
BD239CTU	KSC5338D
KSC2073H2TU	KSC5338D
KSA940TU	KSC5338D
KSC2073TU	KSC5338D
BD239C	KSC5338D
FYP2010DNTU	FYP2010DNTU
FYP1010DNTU	FYP2010DNTU
FYP2006DNTU	FYP2010DNTU
MBRP3045NTU	FYP2010DNTU
MBRP3010NTU	FYP2010DNTU
MBRP1545NTU	FYP2010DNTU